

シンポジウム 高密度基板への微細化技術

-プリント基板はレーザビアからフォトビアへ-



エレクトロニクス部会

2018 年第 2 回シンポジウム

- 日時 2018 年 11 月 2 日（金） シンポジウム 13:00-17:20 交流会 17:20-18:30
- 会場 靱公園内 大阪科学技術センター（アクセス：新大阪から地下鉄御堂筋線で本町下車、徒歩 8 分）
募集人員 70 名 ※申し込み先着順で、定員になり次第締め切ります。
- 主催 公益社団法人化学工学会 エレクトロニクス部会
- 協賛 電子 SI 連絡協議会 (ESIC)、表面技術協会、JIEP、JPCA、MSTE
- 内容

ビッグデータ、AI、5G に対応するためにスマホ、サーバ用のプリント基板には、高機能・高密度化が求められている。プリント基板ではレーザでビアが形成されていたが、データの大容量・高速化伝送の必要性に伴い、微細加工が可能なフォトビアが必要となっている。レーザビア用の層間絶縁樹脂は SiO_2 （シリカ）を分散させ線膨張を下げている。しかしながらフォトビア用樹脂では SiO_2 を分散すると光が透過せずビア形成ができずそのため線膨張率が高い。これらのスマホ・サーバ用半導体からプリント基板への要求とその解決策としてのフォトビア材料の実用化を解決するための方策について議論する。

■プログラム

5 μm 以下のプリント基板配線技術	Rising Technologies Co., Ltd	明島周三（元東芝技監）
大型基板の高密度配線形成ソリューション	株式会社 アルバック	森川 泰宏
高密度基板設計のための CAD ツール	株式会社 図研	長谷川 清久
露光装置の大型基板への対応	株式会社 オーク製作所	佐藤 仁
大型基板への CMP 技術	釜山大学	丁 海島
ビア埋め込みの低線膨張めっき液	株式会社 微小めっき研究所	近藤 和夫

オーガナイザ 近藤 和夫（株式会社微小めっき研究所）、武野泰彦（グローバルネット株式会社） 敬称略

- 参加費 当日受付にてお支払いください。領収書を用意いたします。

大学関係者、学生	無料
化学工学会エレクトロニクス部会 個人会員、団体会員各社の社員	2,000 円
上記以外の化学工学会会員	5,000 円
電子 SI 連絡協議会 (ESIC)、表面技術協会、JIEP、JPCA、MSTE 各会員	5,000 円
その他一般	10,000 円
※エレクトロニクス部会に同時加入いただける方の参加費（初年度年会費免除）	7,000 円

交流会費 4,500 円

■申込先

大阪府立大学微小めっき研究センター 嘉田

electronic-d@21c.osakafu-u.ac.jp (or z0000369@osakafu-u.ac.jp) Tel 0725-51-2693 まで

下記事項を明記の上、お申し込みください。

1. 氏名（フリガナ）
2. 勤務先および住所（所属部署まで）
3. メールアドレス、
4. Tel/Fax
5. 懇親会参加の有無
6. 会員資格（化学工学会会員、化学工学会エレクトロニクス部会員/団体会員の社員、ESIC、表面技術協会、JPCA、JIEP、MSTE、大学関係者、その他一般）